

# 障害解析



shaping tomorrow with you

FUJITSU

## 1. ご提供ソリューション

### ■故障解析

障害発生メカニズムの解明、障害の影響度予測、対策立案に関するご相談に対応させていただきます。

## 2. 各種解析装置と主な活用シーン

### ① デジタルマイクロスコープ

試料を非破壊で高精細に拡大観察する装置

- 【観察項目】
- ・ 試料の観察/形状測定
  - ・ はんだ等の体積測定
  - ・ 断面形状測定 等

### ② 三次元測定装置

非接触で試料の表面凹凸、反り等の測定を行う装置

- 【測定項目】
- ・ 基板や部品の形状測定（そり、変形等）
  - ・ 加工品の寸法測定

### ③ 高温観察装置

はんだ接合過程の変化をリアルタイムに連続観察する装置

- 【観察項目】
- ・ チップ、BGA部品などのはんだ付け状態の観察。
  - ・ SC版開口仕様調査。
  - ・ 不良モードの再現。
  - ・ サイドボール、マンハッタンなど不良モードの再現及び原因調査

### ④ SEM解析装置・EDX解析装置

電子を照射することで、試料表面を高倍率（最大10万倍）で観察する装置

- 【観察項目】
- ・ 金属疲労の観察
  - ・ 異物の付着状態観察
  - ・ 半田の組成・拡散状態観察
  - ・ 半田クラックの観察

### ⑤ EPMA解析装置

試料に電子を照射することで、極微量元素を高精度で分析する装置

- 【分析項目】
- ・ 半田の組成・拡散状態分析
  - ・ 半田クラックの観察・分析



デジタルマイクロスコープ



SEM解析装置・EDX解析装置



三次元測定装置



EPMA解析装置



高温観察装置

お問合せ先 (株)富士通ITプロダクツ  
ビジネス推進センター  
0120-864-733 <http://jp.fujitsu.com/group/fjit/>

